

8290

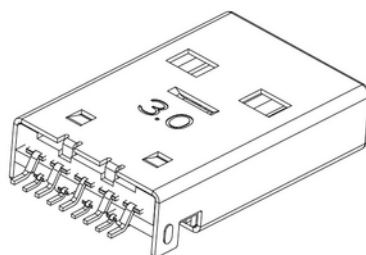
SMT USB 3.0 Steckverbinder, Typ A, Stecker liegend SMT USB 3.0 Connectors, Type A, Plug Horizontal

Technische Daten / Technical Data

Gehäuse	Kupferlegierung, vernickelt
Shell	Copper alloy, nickel plated
Isolierkörper	Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94 V-0, blau
Insulator	Thermoplastic, rated UL94 V-0, blue
Kontaktmaterial	Kupferlegierung
Contact Material	Copper alloy
Oberfläche Lötanschluss	Verzinkt
Plating Solder Side	Tin plated
Lötbarkeit	IEC 60512-12A
Solderability	IEC 60512-12A
Durchgangswiderstand	< 30m Ω VBUS/GND im Auslieferungszustand < 50m Ω im Auslieferungszustand
Contact Resistance	< 30m Ω VBUS/GND initially < 50m Ω initially
Isolationswiderstand	> 10 ⁸ Ω
Insulation Resistance	> 10 ⁸ Ω
Spannungsfestigkeit	100V _{AC}
Test Voltage	100V _{AC}
Nennspannung	30V _{RMS}
Voltage Rating	30V _{RMS}
Nennstrom	1,8A VBUS/GND, 0,25A DATA
Current Rating	1.8A VBUS/GND, 0.25A DATA
Temperaturbereich	-30°C ... +85°C
Temperature Range	-30°C ... +85°C
Verarbeitung	Reflow-Lötverfahren
Processing	Reflow soldering



© W+P PRODUCTS

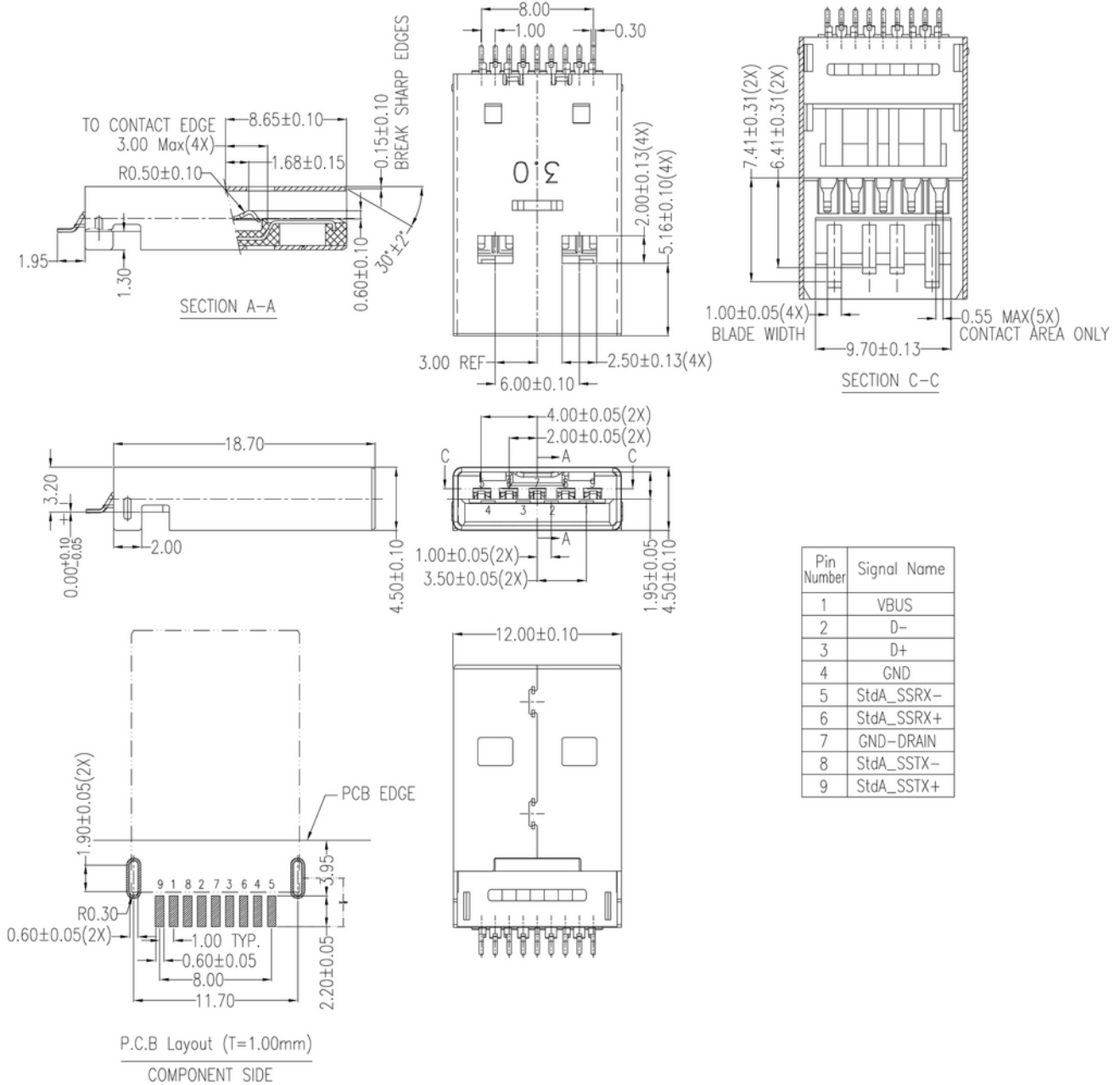


USB 3.0 Type A Male

8290-3-80-00

8290

SMT USB 3.0 Steckverbinder, Typ A, Stecker liegend SMT USB 3.0 Connectors, Type A, Plug Horizontal



Series

8290

Type

3

3 Type A Stecker
Type A male

Plating

80

80 Vergoldet 30µ"
30µ" gold plated

Package

00

00 Schüttgut
Bulk goods

Reflow-Löttempfehlung

Reflow Soldering Recommendation

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum T_{Smin}	150°C
Temperatur Maximum T_{Smax}	200°C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Temperatur Lötbereich T_L	217°C
Verweildauer oberhalb T_L	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Höchsttemperatur T_P	260°C ±5
Dauer Höchsttemperatur	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Dauer 25°C - Höchsttemperatur T_P	Max. 8 min

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature T_{Smin}	150°C
Maximum Temperatur T_{Smax}	200°C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Soldering Range Temperature T_L	217°C
Duration above T_L	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Peak Temperature T_P	260°C ±5
Duration Peak Temperature	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Duration 25°C - Peak Temp. T_P	Max. 8min

